

成膜受託加工

CVDプロセスのファンドリサービスは、クラス1000のクリーンルームの環境下で成膜加工を行います。半導体基板、電子部品に対してパーティクル、汚染を抑えて加工する事が出来ます。高密度プラズマCVDは、50°C以下の低温で高品質な膜を成膜する事が可能であり、多種多様な製品に対応致します。

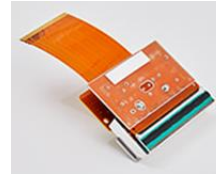


受託加工例

電子部品の保護膜

成膜例：高密度SiO₂ (～50μm)
特性：高絶縁、高防湿、低応力

プリンター



抵抗器



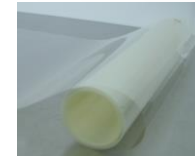
水蒸気バリア膜

成膜例：SiON (～5μm)
特性：10⁻⁵g/m²/d

有機ELデバイス



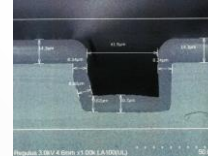
バリアフィルム



超厚膜

成膜例：SiO₂
特性：～50μm

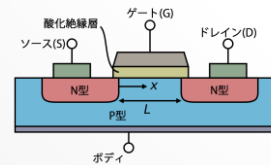
ICパッケージ



低温高絶縁膜

成膜例：高密度SiO₂ (100nm)
特性：10MV/cm

半導体ゲート



プラズマ処理

処理例：低ダメージ表面処理
装置：ICPプラズマ

プラズマ洗浄



シロキサン除去



基板 & 膜種

形状 & サイズ



ウエハー (～ ϕ 300mm)



板状 (\square 1000mm)



湾曲 (ϕ 200mm)

材質

シリコンウエハー、化合物ウエハ、セラミックス、ガラス、樹脂、金属
他 (デバイス基板、半導体パッケージ)

膜種

SiO₂、SiON、SiN、a-Si、C、SiC、SiCN、SiOC、SiOCN